

NOTES:

MATERIAL:

- 1.HOUSING MATERIAL :GLASS FILLED POLYESTER(UL94V-0).
- 2.CONTACT MATERIAL :PHOSPHOR BRONZE $\phi 0.46\text{mm}$ (C5100).
- 3.PLATING :GOLD PLATING OVER NICKEL.
- 4.SHIELD: COPPER ALLOY 0.20mm THICKNESS PLATING NI.

ELECTRICAL:

- 1.VOLTAGE RATING :125 VAC RMS.
- 2.CURRENT RATING :1.5 AMP.
- 3.CONTACT RESISTANCE :50 MILLIOHMS MAX.
- 4.INSULATION RESISTANCE :500 MEGOHMS MIN @ 500V DC.
- 5.DIELECTRIC WITHSTANDING RESISTANCE :1000V AC RMS 50Hz. 1MIN.

MECHANICAL:

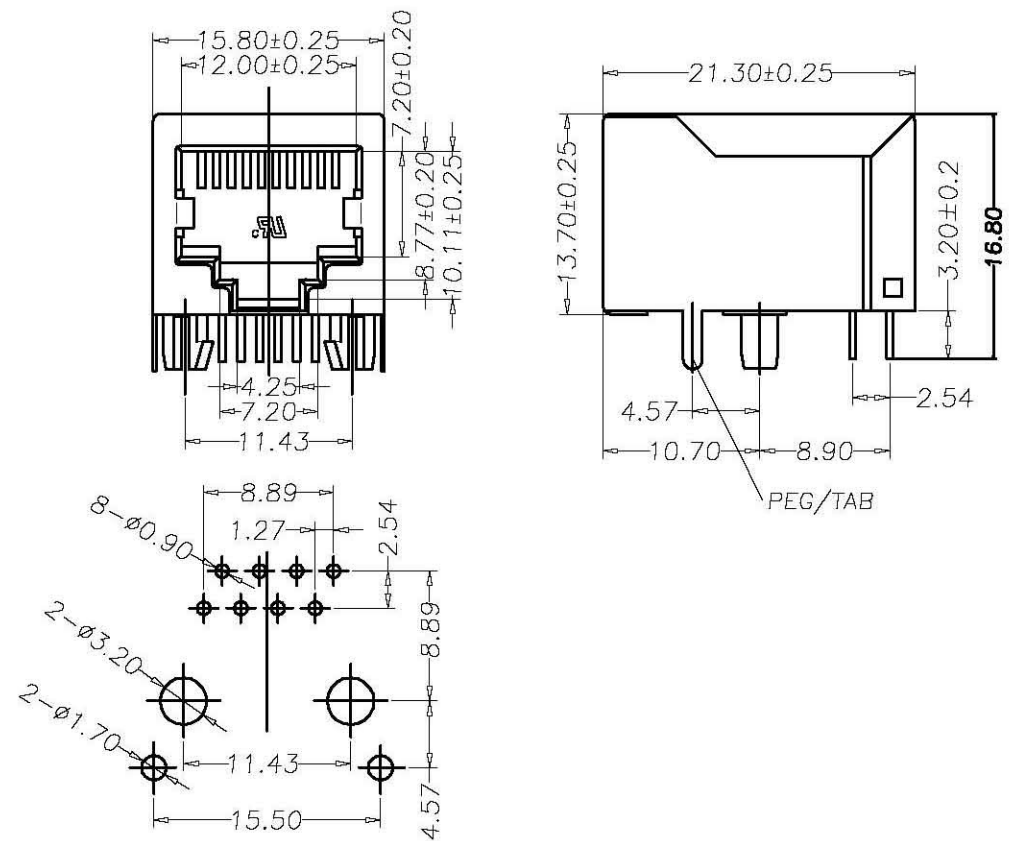
- 1.DURRABILITY :750 CYCLES MIN.
- 2.PCB RETENTION PRE-SOLDER :1 LB MIN.

ENVIRONMENTAL:

- 1.STORAGE : -40°C TO $+85^{\circ}\text{C}$.
 2. OPERATION : 0°C TO 70°C .
- MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO FCC PART 68,SUBPART F.

PART NUMBER:

REVISION RECORD				
REV	ECD	DESCRIPTION	DRFT	CHKD
△		原始版本	XIANWENZ 08.08.04	



PC Board Layout

DETACHED LISTS	MM (INCH)	设计 zhangwei 日期 13.03.10	深圳市连欣科技有限公司	
	一般公差 按	审核	日期	系列 名称
	MM	批准 zhang ke 日期 13.03.10	系列	RJ45 JACK 10P8C-A
	.0 ± 0.20 ±	材料:	图号 △ JR-59-001	版本 A
	.00 ± 0.15 ±	数量:	料号: XDRJ-5806-0213	A4 A
.000 ± 0.075 ±	角度 ± 0.01°	表面处理:	不按比例 共 X 页 第 Y 页	
第三角视图	比例: 1:1			